

PCN # 20141105000
一部製品 新部材(BOM) / 組立サイト認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20141105000	PCN 日付:	12/03/2014																										
表題:	一部製品 新部材(BOM)/組立サイト認定																												
PCN 詳細																													
変更内容:																													
TI は、下記 Group 1 記載の対象製品について新部材セット、下記 Group 2 記載の対象製品について、新組立サイト及び新部材セットの認定を連絡します。 Group 1 は、bond wire option として Cu(銅)ワイヤを追加します。現行組立サイトの変更はありません。 Group 2 は、新組立サイト及び bond wire option として Cu(銅)ワイヤを追加します。 Group 1 Devices: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bond Wire type</td> <td>Au</td> <td>Cu, Au</td> </tr> </tbody> </table> Group 2 Devices: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assembly Site</td> <td>SCSAT</td> <td>TI Clark</td> </tr> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>R008-0097X</td> <td>4207123</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>R003-0301X</td> <td>4208625</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire Type</td> <td>Au</td> <td>Cu, Au</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Package Singulation</td> <td>Punch</td> <td>Saw</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Note: sawn package は、punched package と下位互換性がある(backwards compatible)と認識されています (PCB footprint の変更は不必要等)。追加組立サイトにおける梱包部材(梱包箱,テープ/リール等)は、現行サイトで使用されている部材と同一になります。					Current	New	Bond Wire type	Au	Cu, Au		Current	New	Assembly Site	SCSAT	TI Clark	Mount Compound	R008-0097X	4207123	Mold Compound	R003-0301X	4208625	Bond Wire Type	Au	Cu, Au	Package Singulation	Punch	Saw		
	Current	New																											
Bond Wire type	Au	Cu, Au																											
	Current	New																											
Assembly Site	SCSAT	TI Clark																											
Mount Compound	R008-0097X	4207123																											
Mold Compound	R003-0301X	4208625																											
Bond Wire Type	Au	Cu, Au																											
Package Singulation	Punch	Saw																											
変更理由:																													
供給能力確保 1) 業界技術動向に合わせて、向上した機械的/電気的特性のワイヤを使用します。 2) 組立/検査量産サイトの柔軟性を最大限にします。 3) Cu(銅)は、入手及び保管がより容易になります。																													
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																													
None.																													

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例：

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等